



# LEXCMGX

Laminate

Prepreg

## R-1515W

## R-1410W

高弾性・  
低熱膨張半導体パッケージ基板材料

優れた弾性率と更なる耐熱性を付与し、多ピン化・伝送回路集積化に伴う大型パッケージの高機能化に貢献

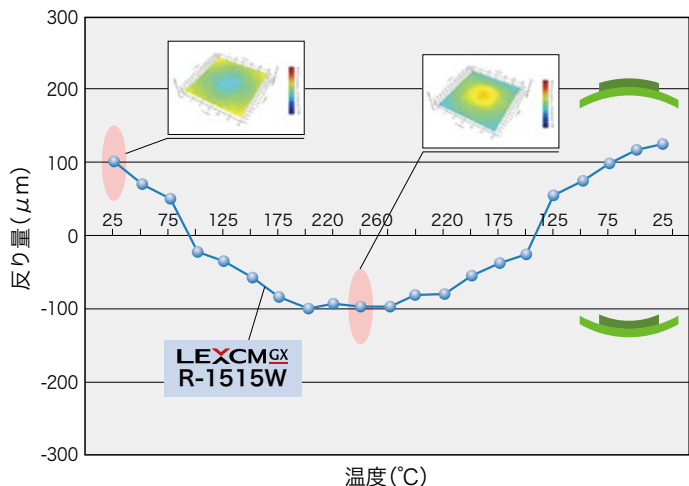
曲げ弾性率  
25°C 35GPa

CTE x, y-axis  
9ppm/°C

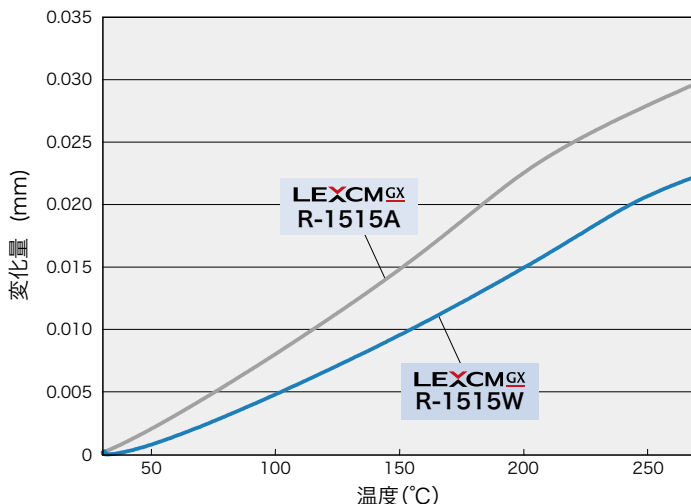
Tg(DMA) 250°C

用途  
**半導体パッケージ**  
半導体パッケージ基板

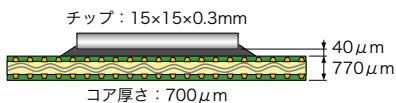
### パッケージ基板反り評価結果



### 熱膨張量(タテ方向)



### 構成



回路長さ：10mm  
基板厚さ：0.8mm (8ply)  
評価方法：TMA

### 一般特性

項目	試験方法	条件	単位	LEXCMGX R-1515W
ガラス転移温度(Tg)	DMA <sup>※2</sup>	A	°C	250
熱分解温度(Td)	TGA	A	°C	390
熱膨張係数(タテ方向)	社内法	A	ppm/°C	9
熱膨張係数(ヨコ方向)				9
熱膨張係数(厚さ方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A		22
				97
曲げ弾性率 <sup>※1</sup>	JIS C 6481	25°C	GPa	35
		250°C		21

試験片の厚さは0.1mmです。

※1 0.8mm ※2 曲げモードでの測定

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

Panasonic Industry R-1515W

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

© Panasonic Industry Co., Ltd. 202410